

底面加熱フィルムコーティング装置

商品番号: TB08



前書き

セラミック結晶電池およびナノフィルム用の底面加熱フィルムコーティング装置。調整可能なコーティング速度、精密な膜厚制御、真空固定、室温から150℃までの加熱乾燥機能を備え、信頼性の高い実験室研究および材料加工において再現性のある結果を実現します。

詳細を学ぶ

用途	説明	主な利点
セラミック薄膜研究	高温成膜研究のため、セラミックスラリーまたは機能性セラミック材料を支持基材上にコーティングします。	制御されたコーティング速度と0.01 mmの膜厚制御により、再現性のある材料比較をサポートします。
結晶フィルム開発	均一なスラリー塗布と制御された乾燥条件が必要な結晶関連フィルムを作製します。	室温から150℃までの底面加熱により、コーティング後の乾燥条件を明確に設定できます。
電池電極作製	実験室での電極およびセル作製研究向けに、アルミニウム箔または銅箔へ電池材料スラリーを塗布します。	真空固定により基材の移動を抑え、プログラム可能なコーティング移動により一貫した電極作製をサポートします。
特殊ナノフィルム研究	精密なブレード調整と制御された移動が必要な実験室コーティングプロセスを用いて、特殊ナノフィルムを開発します。	微細なコーティング制御と調整可能な速度により、プロセス変数を体系的に評価できます。
先端材料研究	高温研究要件のもとで、新規材料の成膜挙動およびコーティング条件を検討します。	コーティング機能と加熱機能の組み合わせにより、小規模なプロセス開発を簡素化します。

大学および実験室でのプロセス研究	材料科学実験、配合スクリーニング、比較試験向けに、再現性のあるコーティング試料を作製します。	タッチスクリーンによるパラメータ設定、コンパクトなサイズ、自動コーティング動作により、作業効率を向上させます。
------------------	--	---

パラメータ	仕様
モデル	TB08
標準コーティング装置幅	100 mm
真空プレート	真空アルミニウム平板付属
付属真空ポンプ	オイルフリー真空ポンプ1台
制御システム	PLCおよびタッチスクリーン制御
コーティングストローク設定	0～300 mm、タッチスクリーンから設定
電源	220 V / 50 Hz
重量	50 kg
全体寸法	L550 mm × W350 mm × H320 mm

パラメータ	仕様
コーティング速度	0~120 mm/秒、調整可能
ブレード厚さ調整範囲	0~5 mm
コーティング厚さ制御精度	0.01 mm
真空プレート加熱および乾燥システム	室温から150℃
温度コントローラー	デジタル表示温度コントローラー
温度制御精度	±1℃
真空プレート寸法	L415 mm × W200 mm × H32 mm

基材	幅	厚さ	面密度
アルミニウム箔	50~200 mm	10~50 μm	27~135 g/m ²
銅箔	50~200 mm	6~20 μm	53~178 g/m ²

手順	操作
1	電極シートを真空プレート上に置き、電源を入れて真空を作動させ、電極シートをプレートに固定します。
2	コーティング装置を電極シート上に置き、コーティングスラリーを投入します。
3	コーティングサイクルを開始します。コーティング装置が自動的に前進し、コーティング操作を完了します。
4	コーティング装置とブッシュロッドを取り外し、加熱温度と時間を設定して加熱乾燥を行います。
5	乾燥が完了したら、コーティング済み電極シートを取り外し、コーティング装置をリセットします。